

全自動万能回転型ミクロトーム (樹脂包埋標本対応)

機種名

ライカマイクロシステムズ株式会社
型式 RM2265
機器番号:0572-00



用途概要

硬いブロックを安定したスピードで切ることができ、様々なタイプの標本から高品質な切片の作製が可能です。

主な仕様

切片厚設定範囲:0.25-100 μ m

0.25
0.50-5.0 μ m間、0.5 μ m刻み
5.0-20.0 μ m間、1.0 μ m刻み
20.0-60.0 μ m間、5.0 μ m刻み
60.0 μ m-100.0 μ m間、10.0 μ m刻み

最大試料サイズ(L×H×W):50×60×40mm

ナイフホルダー:E. LOWプロファイル ウォーターボード付

持込品、注意点等

【持込品】

ミクロトーム用の替刃をご持参ください。

※・使用される刃は大変よく切れ危険です。取り扱いには十分注意して下さい。

【注意点】

パラフィンの削りカスの廃棄について:

組織等が含まれていますので、「感染性廃棄物」に分別して廃棄してください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。

※利用申請の際は機器番号をお知らせください。